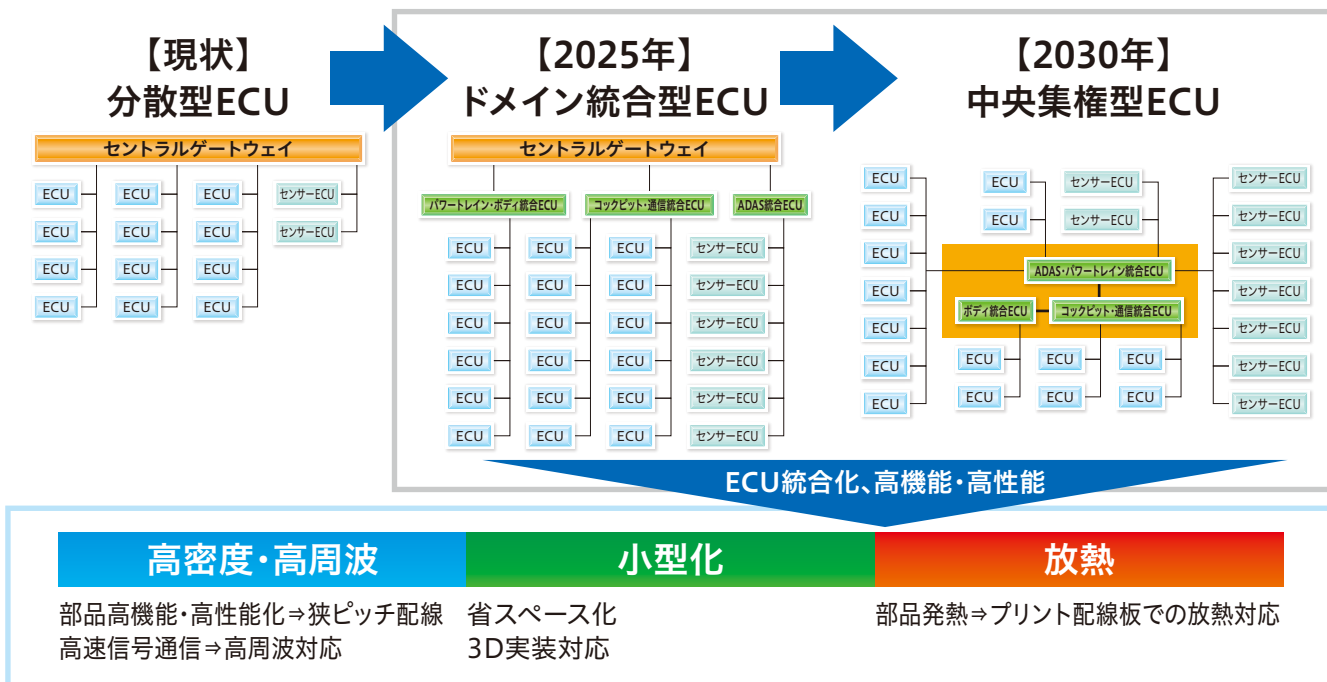


車載用途プリント配線板 技術ラインナップ

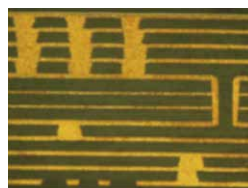
Automotive PWB Technology Lineup

プリント配線板に求められる技術



技術ラインナップ Technology Lineup

HDI基板 (LVH Stack構造)



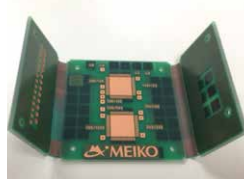
- LVH接続による高密度配線
- 高密度配線による配線スペース小
- LowDk/Df基材

AnyLayer構造



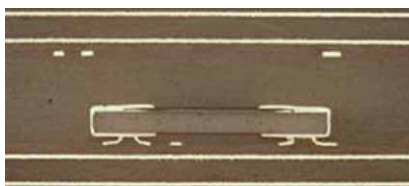
- AnyLayer接続による高密度配線
- AnyLayer接続による配線スペース小
- LowDk/Df基材

FR-4Flex構造 (Semi Flex)



- FR-4.0、4.1を使用した折り曲げ
- 小型・省スペースへの組み込み

部品内蔵構造 (Embedded Devices)



- 基板内部へ部品内蔵し配線面積削減
- 発熱部品を放熱側へ内蔵し放熱効率UP

厚銅構造 (Heavy Cu)



- 電流配線層厚銅化
- 6L貫通 内層105μm

銅インレイ構造 (Cu-Inlay)



- 銅インレイを通した部品の放熱

MegaTH構造



- 選択THめっき厚付けによる放熱

一般TH MegaTH

メタルベース構造 (Metal Base)



- 金属ベース構造での放熱